

GX709 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装的可编程电阻器温度开关

1 特性

- 阈值精度:
 - 典型值±0.5℃
 - 最大值±3℃(+60℃至+100℃时)
- 由1%外部电阻器设定的温度阈值
- 低静态电流: 典型值为 33μA
- * 开漏、低电平有效输出级
- 可通过引脚选择的2℃或者10℃温度滞后
- V_{CC}=0.8V上指定的复位操作
- 电源范围: 2.7V至5.5V
- 封装方式: 5引脚SOT23、6引脚DFN封装

2 应用范围

- 计算机(笔记本和台式机)
- 服务器
- 工业用和医疗用设备
- 存储区域网络
- 汽车电子

3 芯片概述

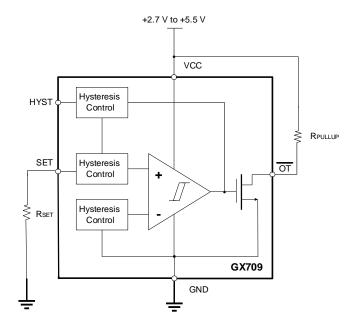
GX709是一款完全集成的、可编程电阻器温度开关,在其全工作范围内,只需一个外部电阻器即可设定温度 阈值。GX709 提供一个开漏、低电平有效输出和一个介于2.7V至5.5V的电源电压范围。

温度阈值精度的典型值为 ± 0.5 °C而最大值为 ± 3 °C (± 60 °C至 ± 100 °C时)。静态流耗的典型值为 33μ A。可通过引脚选择来确定 2°C或者 ± 10 °C的温度滞后。

GX709采用5引脚SOT23和小尺寸DFN6L封装。

芯片封装信息

产品编号	封装信息	芯片封装面积(NOM)
GX709	裸片	0.919 mm × 0.579 mm
GX709S	SOT23-5	2.80 mm × 1.60 mm
GX709D	DFN6L	1.5 mm ×1.5 mm

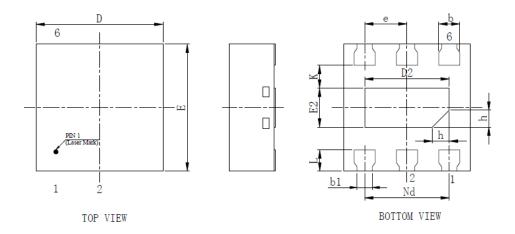


芯片内部结构图

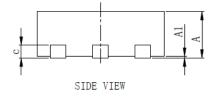


8 封装信息

DFN6L 芯片外形及 PCB 尺寸信息



SYMBOL.	MILLIMETER				
STMBOL	MIN	NOM	MAX		
A	0. 50	0.55	0.60		
A1	0	0.02	0. 05		
b	0. 20	0. 25	0.30		
b1	0. 18REF				
С	0. 152REF				
D	1. 45	1. 50	1. 55		
D2	0. 90	1. 00	1. 10		
e	0. 50BSC				
Nd	1. 00BSC				
E	1. 45	1. 50	1. 55		
E2	0. 36	0. 46	0. 56		
L	0. 20	0. 25	0. 30		
h	0.15	0. 20	0. 25		
K	0. 27REF				



9 订购信息

购买编码	器件	封装	标准包装数量	备注
GX709-T&R	GX709	Die	3000	裸片出货,卷带包装
GX709S-T&R	GX709	SOT23-5	3000	卷带包装
GX709D-T&R	GX709	DFN6L	4000	卷带包装